

Автоматическое оборудование для удаления припоя и исправления дефектов пайки компонентов BGA ASE2500L



Производитель:

Seamark

Цена:

Цена по запросу

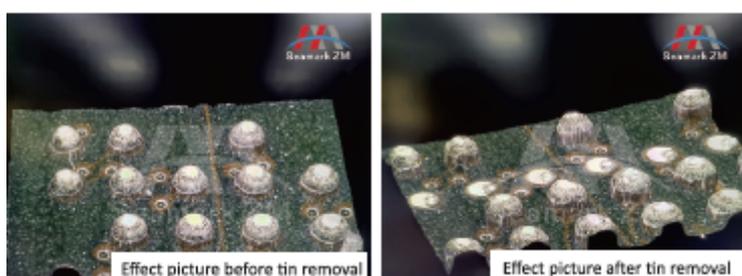
Описание

Полностью автоматическое встроенное в линию оборудование для удаления припоя/исправления дефектов пайки компонентов BGA/пайки. Подходит для ремонта дефектных изделий в процессе сборки полупроводниковых кристаллов, используется одноточечная лазерная система. В системе исправления дефектов пайки компонентов BGA и пайки применяется человеко-машинное управление, интеллектуальная система движения. Можно хранить несколько наборов программ с рецептами обработки изделия. Возможна простая и быстрая перенастройка линии на другое изделие. Стандартная загрузка и выгрузка

компонентов SMT, регулируемые компоненты на зубчатой ленте с ESD можно подключить к другому технологическому оборудованию выше или ниже в производственной линии. Обеспечена общая высокая совместимость и совместим со стандартными в отрасли лотками BGA.

Бесконтактное односточечное удаление припоя

Используется бесконтактная головка для удаления припоя в одной точке. С помощью высокоточного лазерного датчика измерения высоты и прецизионного датчика веса удаление припоя в одной точке может эффективно устранять дефекты изделий в одной точке без необходимости удаления припоя на всей детали. Это повышает эффективность удаления припоя, сокращает объем отходов, снижает риск повреждения BGA и брака при удалении припоя.



Система исправления односточечных дефектов пайки компонентов BGA и лазерной пайки

Четыре набора независимых игл используются для односточечного переноса флюса из флюсовой системы на монтажные площадки.

Четыре набора независимых присосок наносят шарики припоя на контактные площадки, которые затем затвердевают с помощью лазерной пайки.

Три комплекта системы визуализации CCD

Оснащено тремя комплектами систем технического зрения CCD и используется программное обеспечение собственной разработки для обнаружения материалов в лотке и их точной загрузки и выгрузки. AOI обнаруживает и точно определяет местоположение дефектов на изделии. После смены линии сопло для исправления дефектов пайки компонентов BGA автоматически калибруется.

Четыре комплекта независимых платформ предварительного нагрева

Предусмотрено четыре набора независимых платформ предварительного нагрева. Платформа предварительного нагрева оснащена системой нагрева и контроля температуры. На платформе предварительного нагрева

осуществляются удаление припоя и исправление дефектов пайки компонентов BGA. Как платформа предварительного нагрева, так и головка для удаления припоя используют замкнутый контур контроля температуры. Общий контроль температуры является стабильным и точным.